

生成 AI/ポスト 5G 時代の冷却戦略

～サーマル技術が支える未来の情報社会～

- 日時** 2025 年 12 月 1 日(月)10:00～17:30 *終了後交流会実施
■会場 機械振興会館(東京都港区芝公園 3-5-8) *オンライン併用開催
■主催 公益社団法人化学工学会 エレクトロニクス部会
■共催 一般社団法人エレクトロニクス実装学会 サーマルマネジメント研究会
■協賛 エレクトロニクス実装学会(JIEP)、日本電子回路工業会(JPCA)、表面技術協会、スマートプロセス学会エレクトロニクス生産科学部会(MSTE)、よこはま高度実装技術コンソーシアム(YJC)、NPO 法人サーキットネットワーク(C-NET)、IEEE EPS Japan Chapter、日本伝熱学会、化学工学会 熱工学部会、自動車技術会 ※協賛予定を含む。他複数のサーマル関係の団体に協賛打診中

5G・生成 AI の進化により、爆発的に増大するトラフィックを扱うデータセンタは今、電力の大量投入に伴うかつてない熱の壁に直面しています。複雑化・巨大化する一方の演算処理、地球温暖化の加速、そしてエネルギー効率の追求——そのすべてに立ちはだかる「熱」問題。

本シンポジウムでは、最新のサーバや、半導体デバイス/パッケージで不可欠となるサーマル技術の最前線を、エネルギー業界から見た熱問題をはじめ、材料技術、放熱・熱輸送技術など、サーマル技術の基礎から応用までを網羅した 7 講演でお届けします！「熱」に関わるすべての技術者・研究者にとって見逃せない内容です。

熱を制する者が未来を制す。あなたの知見と情熱が次世代の冷却技術を切り拓く。今こそ、熱の最前線へ！
 ご参加を心よりお待ちしております！

■プログラム

1. エネルギー業界から見たデータセンターの現状と課題	MESH-X	矢島 健史 様
2. AI データセンターの冷却技術について 一冷却性能から見える未来	山口東京理科大	結城 和久 様
3. 伝熱の基礎とマイクロプロセッサの熱設計	足利大学	西 剛伺 様
4. ナノからミクロ領域での熱移動と熱物性計測技術	産総研	八木 貴志 様
5. 分子・原子レベルでみた熱制御：重合性液晶材料の可能性	JNC 石油化学	藤原 武 様
6. フリップチップ・パッケージにおける基板側からの放熱における取り組み	日本アイ・ビー・エム	松本 圭司 様
7. ベーパチャンバを用いたサーバ用チップ冷却技術	フジクラ	斎藤 祐士 様

◇オーガナイザ 西 剛伺 (足利大学)、吉野 雄信(株式会社フジクラ)

◇更新情報は、<https://scej-ele.org/contents/04.html> を参照願います。

- 参加費** オンライン参加の場合は事前に指定口座までお振り込みください。お申し込み後、請求書(PDF)を発行いたします。
 会場参加の場合は、現地でお支払いください。領収書をご用意いたします。
 会場参加の方は、終了後の技術交流会にご参加いただけます(別途 4,000 円をいただきます)。

化学工学会エレクトロニクス部会/熱工学部会 個人会員、部会法人会員各社の社員 エレクトロニクス実装学会サーマルマネジメント研究会 会員	5,000 円
上記以外の化学工学会正会員・化学工学会法人会員各社の社員、協賛団体会員	8,000 円
大学関係者(教員、研究員等) ※高専・短大を含む	5,000 円
大学関係者(エレクトロニクス部会員)、学生(高専・短大を含む)	無料
一般参加者	15,000 円
※エレクトロニクス部会賛助会員に同時加入される場合 参加費割引+2026 年度分まで年会費免除	9,000 円

■お申込方法

右記の URL よりご登録ください: <https://forms.office.com/r/3ESPbMG94A> ※参加登録〆切 11/24

オンライン登録が出来ない場合は、メールでお申し込みいただけます。エレクトロニクス部会まで下記内容をご連絡ください。

- ①氏名、②勤務先住所(所属部署まで)、③メールアドレス、④聴講方式(会場参加、またはオンライン参加)、
 ⑤電話番号、⑥会員資格(上記参加費欄の区分を記載)、⑦技術交流会参加有無(参加費 4,000 円を予定)

お問合せ・メールでのお申込先 div_electro@scej.org まで